



<b>NAR Labs</b> 國家實驗研究院 <b>台灣半導體研究中心</b>		DOCUMENT NO. : Q3-NL04	TITLE : 設備作業標準 (SE-028 電子槍蒸鍍系統)		
ISSUE DATE	2021-04-15	REVISION	1.1	PAGE	第 1 / 2 頁

#### 一、目的：

定義電子槍蒸鍍系統操作規範，以確保操作品質。

#### 二、範圍：

適用於電子槍蒸鍍系統。

#### 三、權責：

1. 組織權責：工程師負責制定及修改規範。
2. 執行人員資格：經過電子槍蒸鍍系統考核通過之人員。

#### 四、名詞定義：

無。

#### 五、相關文件：

無。

#### 六、標準作業程序：

1. MES 控制系統開啟設備
2. 操作前檢查項目：
  - 2.1. 檢查冷卻水水流量  $2\text{kg}/\text{cm}^2$
  - 2.2. 檢查氮氣二次盤面流量  $7\text{kg}/\text{cm}^2$
3. 鍍膜製程：
  - 3.1. 點選進入『半自動』畫面後按下【破真空】按鈕。
  - 3.2. 等待破真空結束，【ATM】亮起，放入試片、金屬錠、鎢舟和襯鍋等製程材料
  - 3.3. 設定膜厚計監控器
    - 3.3.1. 按下【Next Menu】選擇操控頁面
    - 3.3.2. 按下【Process Menu...】進入參數設定
    - 3.3.3. 選轉旋鈕至所需要的參數後按下【Edit...】，進入膜層順序設定
    - 3.3.4. 選轉旋鈕至所需要的參數後按下【Edit...】，進入膜層參數設定
    - 3.3.5. 更改【Init Rate】鍍膜速率 和更改【Final Thickness】，鍍膜厚度。
    - 3.3.6. 按下【To main】回到起始畫面

<b>NAR Labs</b> 國家實驗研究院 <b>台灣半導體研究中心</b>		DOCUMENT NO. : Q3-NL04	TITLE : 設備作業標準 (SE-028 電子槍蒸鍍系統)		
ISSUE DATE	2021-04-15	REVISION	1.1	PAGE	第 2 / 2 頁

- 3.4. 進入『鍍膜參數』畫面按下【Film 更新】後檢查和設定參數
- 3.5. 進入『自動』畫面
  - 3.5.1. 按下【更新】，並選擇參數
  - 3.5.2. 按下【自動鍍膜】
- 3.6. 等真空達基本壓力(Base pressure)，約為  $8E-7$  Torr，聽到提示音後，按下【鍍膜】
- 3.7. 進入『資料收集』畫面內監控鍍膜情形
- 3.8. 鍍膜厚度達到後，結束鍍膜製程
- 3.9. 破真空，拿取試片和清潔腔體
4. 回『半自動』畫面，選取【抽真空】
5. MES 控制系統 關閉設備。

#### 七、應用表單及附件：

1. Q4-NL02 設備管理卡
2. Q4-NL03 設備考核表
3. Q4-NL04 設備點檢表
4. Q4-NL06 異常及矯正預防處理單